

Hi512F 小功率差分并联 DMX512 解码恒流驱动

1. 产品特性

- R/G/B/W 恒流输出，3bit 电流增益调节
- 高辉高刷，刷新频率 16KHz
- 专利 GAMMA 平滑技术，低辉渐变更平滑
- 可编程的低辉开启补偿
- 输出电流 $\pm 3\%$
- 静态电流 3mA
- 伽玛 2.2，65536 级辉度
- 解码输出降 EMI 优化，降低过 EMC 成本
- 恒流端口耐压 40V
- 1/2/3/4 通道数量可配置
- 内置 RS485 接收模块
- 内置 EEPROM，4096 寻址，三重备份
- 专利的抗干扰增强
- 内置 5V 稳压电路，工作电压 5-40V
- 宽范围波特率自适应，0.2-1Mbps
- 过温降电流功能
- 封装：SSOP10/MSOP10

2. 应用范围

- 小功率点光源
- 条形灯

4. 芯片选型：

型号	建议电流范围	通道数	封装形式	编带数量(颗/盘)	建议热功率
Hi512FS	4-25.2mA	4	SSOP10	4000	0.5W
Hi512FM	4-25.2mA	4	MSOP10	4000	0.5W

3. 产品说明

Hi512F 是一款支持最高可达 200Kbps - 1Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片，支持 4 路恒流输出，支持 1/2/3/4 通道数量可配，波特率自适应范围广，兼容性好，使用方便可靠。

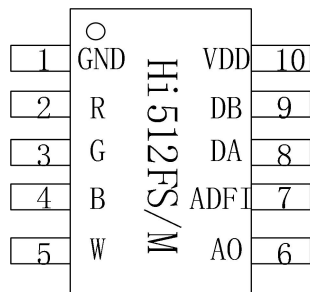
内置 RS485 差分模块，抗干扰强，传输距离远。

内置 EEPROM，支持 4096 寻址范围，且写址后不用重新上电；支持 3 重备份并自动纠错。

恒流输出通道对 EMI 进行优化，方便方案认证。此外高温降电流的过温处理方式避免了传统过温关闭输出带来的灯闪问题，不影响效果。

本芯片输出端口支持 16KHz 刷新率，手机拍摄无频闪。

5. 管脚配置



SSOP10/MSOP10

图 5.1 管脚图

管脚名称	引脚编号	功能描述
GND	1	芯片地底部焊盘为地
R	2	红灯通道驱动输出
G	3	绿灯通道驱动输出
B	4	蓝灯通道驱动输出
W	5	白灯通道驱动输出
AO	6	地址输出
ADFI	7	地址标志信号输入
DA	8	差分输入正极 (A)
DB	9	差分输入负极 (B)
VDD	10	芯片电源

6. 结构框图

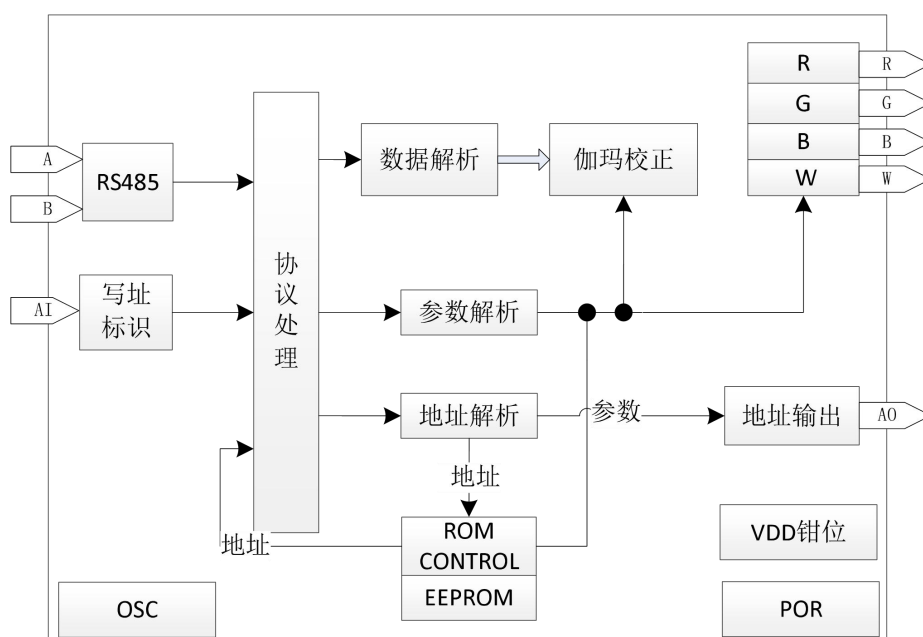


图 6.1 结构原理框图

7. 极限工作参数

符号	说明	范围	单位
VDD	芯片供电	-0.4~6.3	V
逻辑	DA,DB,ADFI,AO	-0.4~VDD+0.5	V
端口	R,G,B,W 端口耐压	-0.4~45	V
Ta	工作温度	-40 - 85	℃
T _{stg}	储存温度	-45 - 150	℃
ESD	抗静电 ESD(HBM)	>4K	V

8. 电气特性

(除非特殊说明, 下列条件均为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
VDD	芯片电源钳位电压	12V 输入加 500 Ω 电阻	5.5		6.3	V
T _{osc}	内部振荡器时钟周期	VDD=5V	50		65	ns
R _{ADFI}	地址标识上拉电阻	VDD=5V		16K		Ω
I _{AB}	差分输入电流	VDD=5V		25		μA
VAB _{CM}	DA DB 脚共模电压	VDD=5V		5		V
VAB	DA DB 脚工作范围	VDD=5V	-0.4		5	V
V _{delay}	DA, DB 端口迟滞电压			200		mV
F _{LED}	LED 扫描频率	VDD=5V		16K		Hz
I _{VDD}	芯片工作电流	VDD=5V		3		mA
AO _H	地址标识上拉电流	VDD=5V, DOUT=0V		60		mA
AO _L	地址标识下拉电流	VDD=5V, DOUT=5V		60		mA
R _{AB}	差分输入阻抗(对地)			220K		Ω
V _{th}	差分输入临界电压			0.2		V
V _{cm}	差分输入共模电压				6	V
I _{SINK}	输出管脚电流	EEP 参数设置		18		mA
R _{G,B,W}	端口耐压			40		V
VDS _I	输出恒流拐点	I _{OUT} =25.2mA		0.7		V
R _{TH}	封装热阻		80		120	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
T _{OVT}	过温处理	降电流的方式		140		$^{\circ}\text{C}$

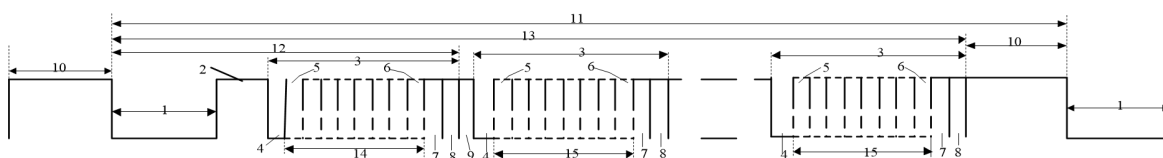
9. 开关特性

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
T _{DELAY}	信号延时	VDD=5.2V			300	ns
T _{ON}	IOUT 开启延时	VDD=5.2V			65	ns
T _{OFF}	IOUT 关闭时间	VDD=5.2V			60	ns
C _{IN}	输入电容	VDD=5.2V		10		pF

注：严禁让芯片长时间工作在过温状态

10. 协议说明

芯片兼容标准 DMX512(1990)协议及拓展 DMX512，数据传输由 200K-1.0Mbps 自适应解码。其波形如下图所示。A/B 线是差分线，图示为 A 线的波形，B 线与之相反。



No.	Description	Min	Typ	Max	Unit
-	Bit Rate	-	250	-	kbit/s
-	Bit Time	3.92	4	4.08	us
-	Minimum Update Time for 513 slots	-	22.7	-	ms
-	Maximum Update Rate for 513 slots	-	44	-	/s
1	"SPACE" for BREAK	88	-	-	us
2	"MARK" After BREAK (MAB)	8	-	<1.00	us
3	Slot time	43.12	44	44.88	us
4	Start bit	3.92	4	4.08	us
5	LSB	3.92	4	4.08	us
6	MSB	3.92	4	4.08	us
7	STOP	3.92	4	4.08	us
8	STOP	3.92	4	4.08	us
9	"MARK" Time Between slots	0	-	<1.00	s
10	"MARK" Before BREAK (MBB)	0	-	<1.00	s

No.	Description	Min	Typ	Max	Unit
11	BREAK to BREAK Time	1196	-	1.00	us
13	DMX512 Packet	1196	-	1.00	us
14	START CODE (Slot 0 Data)	31.36	32	32.64	us
15	SLOT 1 DATA	31.36	32	32.64	us

备注:

1. 字段共 11 位, 0 start 位低电平, 8 个 bit 位, 2 个 stop 位高电平
2. start 位, 数据位, stop 位, 宽度应相同, 以免误采样
3. Start code 段用于波特率自适应检测, 故其宽度应和后面的每个数据段宽度相同, 以免误采样

11. 应用说明

11.1. 典型应用

芯片支持高辉高刷, 刷新频率 16KHz, 手机以及摄像机拍摄无频闪, 支持独家专利的降 EMI 技术以及抗干扰技术。

恒流应用:

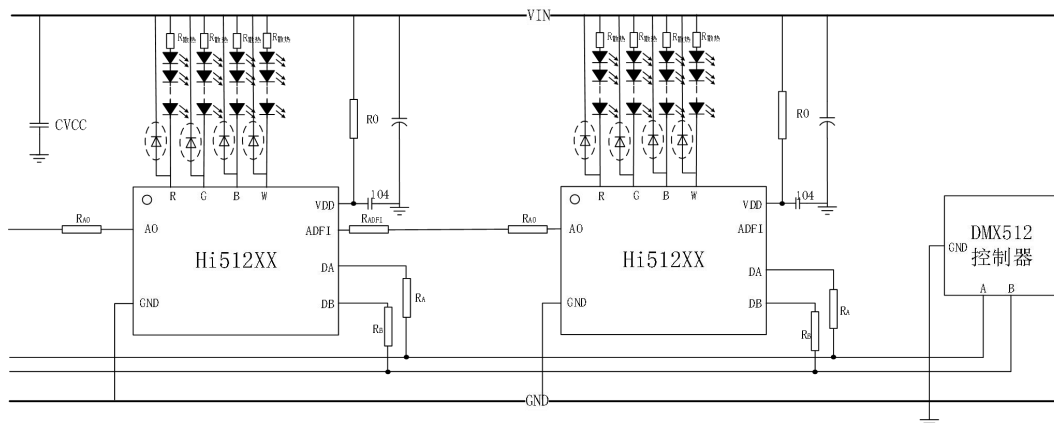


图 11.1.1 典型应用方案 1

- 图中 R0 是 VDD 的供电电阻, 芯片通过 R0 供电, 尽量保证流过 R0 供给芯片的电流超过 I_D (12mA) 以确保芯片在满负荷的时候也能工作。
芯片的主要是通过一个供电电阻 R0 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流, 通常情况下:

$$R_0 = (VIN - VDD) \div I_D \quad \text{其中 } VDD \text{ 选择 } 5.5V$$

下面给出常规应用的设计指导:

VIN (V)	5	12	24
RO (Ω)	20	0.5K	1.5K

实际工程应用中, 针对 VIN 值的选择, 应考虑尾灯上的线损, 以 24V 为例, 若考虑线损, 建议 1.3K。

- RA RB 为差分信号的输入保护电阻, 目的是防止 DA 以及 DB 端口损坏, 一般根据需求选择 3K~10K 的阻值。
- RADFI 电阻为地址标识脚输入保护电阻, 目的是保护地址标识输入端口不会损坏, 阻值选择为 500~1K。
- RAO 电阻为地址标识输出保护电阻, 目的是保护地址标识输出端口不会损坏, 阻值选择为 500~1K。
- 虚线框为可选项, 客户根据实际案子酌情选择, 具体请与我司 FAE 沟通确认。

11.2. 输出恒流配置

R,G,B,W 是恒流输出端口, 最大电流 25.2mA:

芯片可以通过控制器或解码器单独配置每一路的电流, 每一路 8 级可调。

写电流数据	bit2	bit1	bit0	R/G/B/W 恒流 (默认 18mA)
3'd0	0	0	0	0
3'd1	0	0	1	3.6
3'd2	0	1	0	7.2
3'd3	0	1	1	10.8
3'd4	1	0	0	14.4
3'd5	1	0	1	18
3'd6	1	1	0	21.6
3'd7	1	1	1	25.2

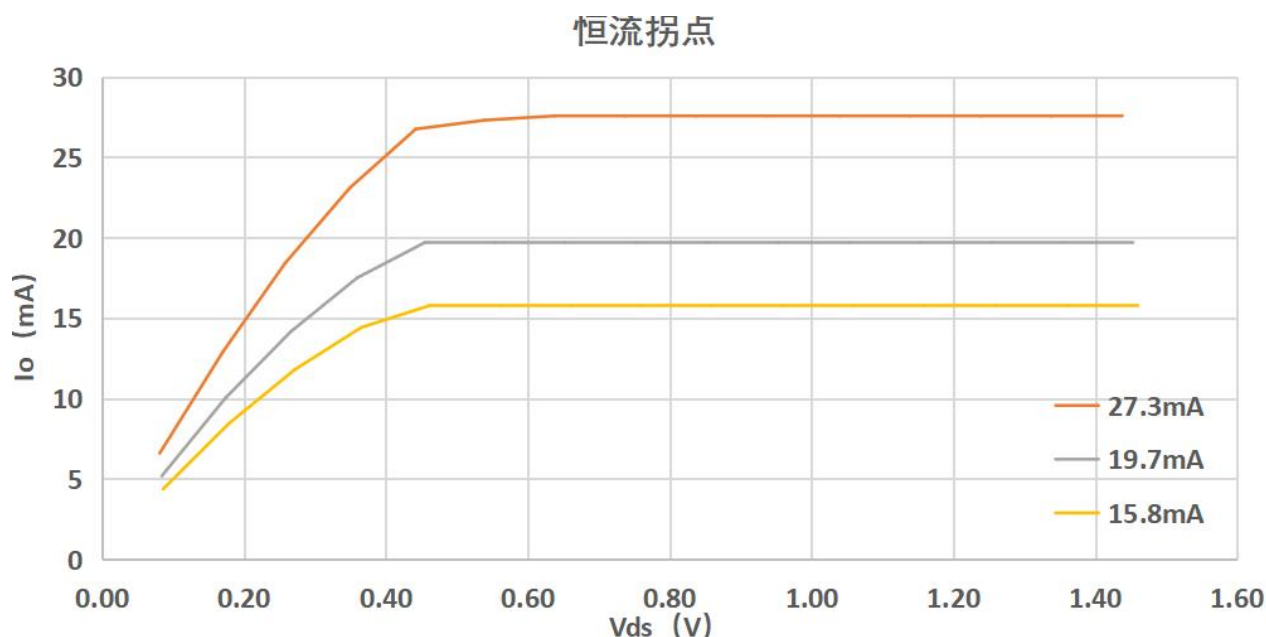


图 10.1 恒流拐点

11.3. 亮灯状态设置

本芯片写参数或者写地址成功后亮灯态均为首灯亮红灯（25%），其余亮绿灯（25%）的模式，状态一直保持到重新上电或者接收到控制器数据才释放。

本芯片还可支持无信号默认色可配，方便客户实现各种需求，比如可以在无信号的情况下，通过使用本芯片的灯光系统显示一幅预先设置好的图案。

11.4. 电流通道配置：

本芯片可以通过控制器或解码器配置电流通道，可以配置 1/2/3/4 通道：

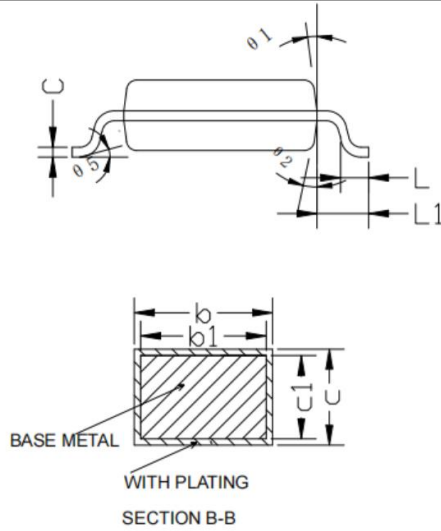
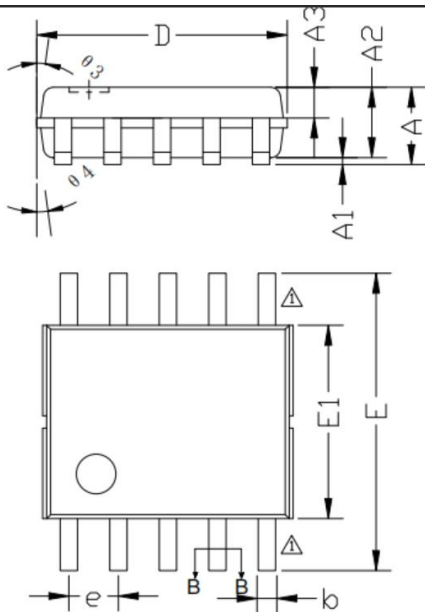
- 截取 1 字段，配 1/2/3/4 字段
- 截取 2 字段，配 1/2 字段，配 3/4 字段
- 截取 3 字段，配 1 字段，配 2 字段，配 3 字段
- 截取 4 字段，配 1 字段，配 2 字段，配 3 字段，配 4 字段

11.5. GAMMA 曲线以及频率：

本芯片支持 GAMMA2.2 和 16KHZ 的 LED 刷新率，方便客户实现高辉高刷显示效果。

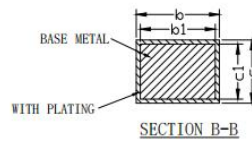
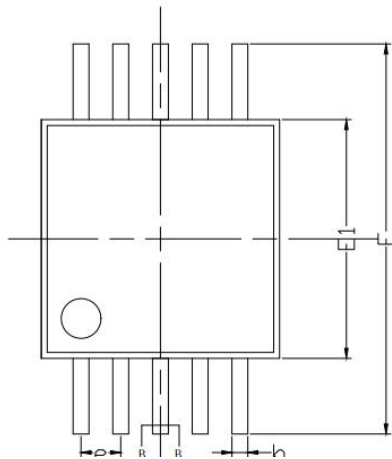
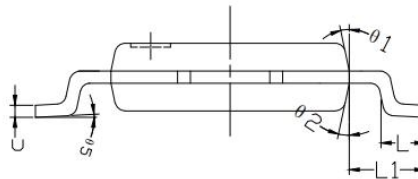
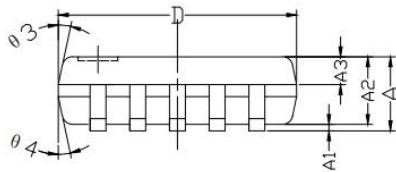
12. 封装信息

Hi512FS(SSOP10)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.65
A1	0.10	--	0.25
A2	1.40	1.42	1.50
A3	0.57	0.62	0.67
b	0.33	--	0.41
b1	0.32	0.35	0.38
c	0.20	--	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.90	6.00	6.20
E1	3.85	3.90	4.00
e	1.00(BSC)		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05(BSC)		
θ1	6°	~	12°
θ2	6°	~	12°
θ3	5°	~	10°
θ4	5°	~	10°
θ5	0°	~	6°

Hi512FM(MSOP10)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.92	0.93	0.94
A1	0.03	0.08	0.13
A2	0.80	0.85	0.90
A3	0.299	0.349	0.399
b	0.13	--	0.27
b1	0.12	0.18	0.24
c	0.152	--	0.192
c1	0.142	0.152	0.162
D	2.90	3.00	3.10
E	4.80	4.90	5.00
E1	2.90	3.00	3.10
e	0.50(BSC)		
L	0.45	0.55	0.65
L1	0.95(BSC)		
theta 1	10°	~	14°
theta 2	10°	~	14°
theta 3	10°	~	14°
theta 4	10°	~	14°
theta 5	1°	~	5°

技术说明:

- 1) LEADFRAME MATERIAL: COPPER;
引线框架材料: 铜;
- 2) LEADFRAME THICKNESS: 0.152mm;
引线框架厚度: 0.152mm;
- 3) BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH;
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶;
- 4) REFERENCE: JEDEC MS-013, MS-012.
参考标准: JEDEC MS-013, MS-012。